

請求の範囲

- [請求項1] 熱硬化性樹脂と、硬化剤と、エラストマーと、無機フィラーとを含有し、
前記硬化剤が脂環式環を有するフェノール樹脂を含み、
前記エラストマーの含有量が、前記熱硬化性樹脂 100 質量部に対して、10～80 質量部である、接着剤組成物。
- [請求項2] 前記熱硬化性樹脂がエポキシ樹脂である、請求項 1 に記載の接着剤組成物。
- [請求項3] 前記エポキシ樹脂がビスフェノール F 型エポキシ樹脂を含む、請求項 2 に記載の接着剤組成物。
- [請求項4] 前記エラストマーがアクリル樹脂である、請求項 1～3 のいずれか一項に記載の接着剤組成物。
- [請求項5] 無機フィラーがシリカである、請求項 1～4 のいずれか一項に記載の接着剤組成物。
- [請求項6] 前記無機フィラーの含有量が、接着剤組成物全量を基準として、25 質量%以上である、請求項 1～5 のいずれか一項に記載の接着剤組成物。
- [請求項7] 前記熱硬化性樹脂、前記硬化剤、前記エラストマー、及び前記無機フィラーの合計の含有量が、接着剤組成物全量を基準として、95 質量%以上である、請求項 1～6 のいずれか一項に記載の接着剤組成物。
- [請求項8] 硬化促進剤をさらに含有する、請求項 1～7 のいずれか一項に記載の接着剤組成物。
- [請求項9] 請求項 1～8 のいずれか一項に記載の接着剤組成物をフィルム状に形成してなる、フィルム状接着剤。
- [請求項10] 基材と、
前記基材上に設けられた、請求項 9 に記載のフィルム状接着剤と、
を備える、接着シート。

- [請求項11] 前記基材がダイシングテープである、請求項10に記載の接着シート。
- [請求項12] 前記フィルム状接着剤の前記基材とは反対側の面に積層された保護フィルムをさらに備える、請求項10又は11に記載の接着シート。
- [請求項13] 基板上に第1のワイヤを介して第1の半導体素子を電氣的に接続するワイヤボンディング工程と、
第2の半導体素子の片面に、請求項9に記載のフィルム状接着剤を貼付するラミネート工程と、
前記フィルム状接着剤が貼付された第2の半導体素子を、前記フィルム状接着剤を介して圧着することで、前記第1のワイヤの少なくとも一部を前記フィルム状接着剤に埋め込むダイボンド工程と、
を備える、半導体装置の製造方法。